

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不擬作為亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦不會成為有關邀請或要約的一部分。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站就本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市刊發的《華虹半導體有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上發行申購情況及中籤率公告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二三年七月二十六日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心（董事長）

唐均君（總裁）

非執行董事：

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壘，太平紳士

葉龍蜚

华虹半导体有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

特别提示

华虹半导体有限公司（以下简称“发行人”或“华虹公司”）首次公开发行40,775.0000万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1228号文同意注册。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（国泰君安及海通证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”或“联席主承销商”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或合称“联席主承销商”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或合称“联席主承销商”）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或合称“联席主承销商”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 40,775.0000 万股。其中初始战略配售数量为 20,387.5000 万股，占本次发行总数量的 50.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 20,387.5000 万股，占本次发行总数量的 50.00%，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。

网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为 16,310.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 4,077.5000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为 20,387.5000 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币 52.00 元/股。

发行人于 2023 年 7 月 25 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“华虹公司” A 股 4,077.5000 万股。

本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注，并于 2023 年 7 月 27 日（T+2 日）及时履行资金交收义务：

1、网下获配投资者应根据《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2023 年 7 月 27 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。**网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。**

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 7 月 27 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下

和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 70%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,644,536 户，有效申购数量为 86,706,646,000 股，网上发行初步中签率为 0.04702638%。配号总数为 173,413,292 个，号码范围为 100,000,000,000—100,173,413,291。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为 20,387.5000 万股，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。战略配售调整后的网下发行数量为 16,310.0000 万股，网上发行数量为 4,077.5000 万股。

由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 2,126.47 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 2,038.7500 万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 14,271.2500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上最终发行数量为 6,116.2500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.07053958%。

三、网上摇号抽签

发行人和联席主承销商定于 2023 年 7 月 26 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2023 年 7 月 27 日（T+2 日）在上交所网站（www.sse.com.cn）公布网上摇号中签结果。

发行人：华虹半导体有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商：国开证券股份有限公司

2023 年 7 月 26 日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）



发行人：华虹半导体有限公司

2023年 7 月 26 日

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2023年7月26日

(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年7月26日



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2023年7月26日



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司

